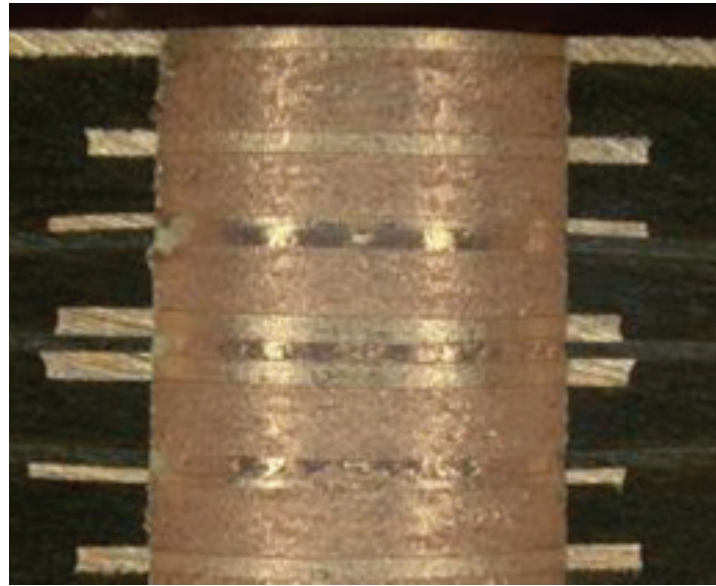


Via Dep 4550

低应力化学沉铜金属化

无应力化学沉铜协助您解决困难材料的工程问题

MacDermid Enthone 的 Via Dep 4550 化学沉铜系统是用于电镀困难的材料金属化首选方案。4550 工艺提供出色的粘附力于惰性难镀表面和困难的结构设计, 同时保持结构完整性。零应力和无气泡的沉积可以轻松满足 SAP, MSAP 和柔性电路板复杂的金属化需求。



主要特性优点

- 无应力铜沉积
- 环保的酒石酸系统
- 低工作温度, 节省操作成本
- 可以兼容柔性电路板, 软硬结合板和硬板的PCB设计
- 直接替代现有的化学沉铜线
- 通过 IPC - TM - 650 导通孔热应力测试



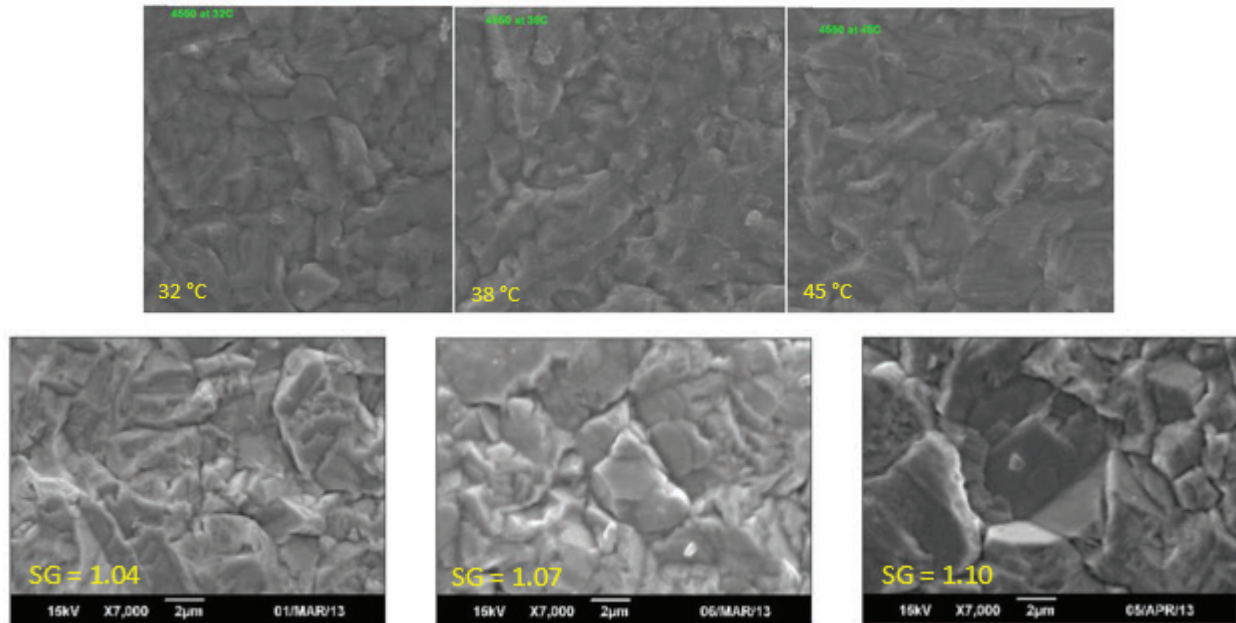
MacDermid Enthone

Via Dep 4550

低应力化学沉铜金属化

稳定且操作简便， 宽广的操作范围、稳定一致的沉积性能

一致性就是一切。由于汽车，医疗设备和家庭电子产品的大幅增加，生产良率变得比以往更加重要。无论是使用过的还是新药水，高温还是低温处理，在多种材料上Via Dep 4550工艺都能提供一致的结合力沉积层。



各种先进材料的结合力



AP 材料的7 Mil盲孔 - 左: 传统化学沉铜, 右图: Via Dep 4550

传统的化学沉铜槽液缺乏Via Dep 4550所具有的优异附着力。专利配方可在软板，软硬结合板和硬板材料上实现高性能金属化，这意味着大量工作只需要一种槽液。



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS